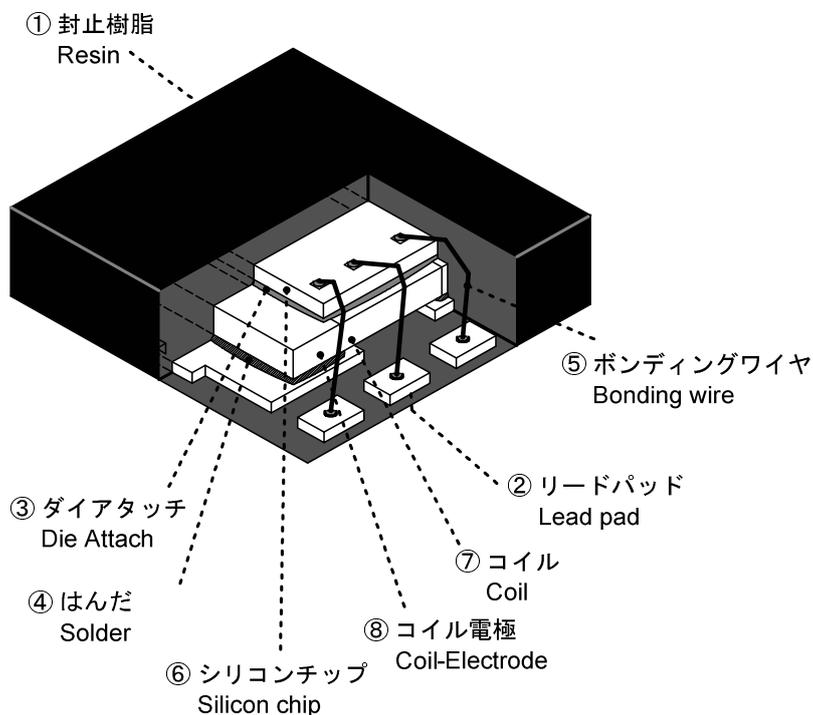


USP-10B03構造図  
USP-10B03 Perspective

RoHS対応品  
RoHS Compliance



項目 Item	材料 Material	備考 Note
① 封止樹脂 Resin	エポキシ樹脂 Epoxy resin	難燃グレード/Flammability rating UL94V-0
② リードパッド Lead pad	ニッケル Nickel	
端子処理 Outer pad plating	Auメッキ Gold plating	
③ ダイアタッチ Die attach	エポキシ Epoxy	
④ はんだ Solder	鉛フリーはんだ Pb-free solder	
⑤ ボンディングワイヤ Bonding wire	Au	
⑥ シリコンチップ Silicon chip	Si	
⑦ コイル Coil	セラミック Ceramic	
⑧ コイル電極 Coil-Electrode	Ni 下地めっき + Snめっき Ni pre-plating + Sn plating	

捺印表示 Marking	レーザー Laser marking
-----------------	-----------------------